

자동 가열 유압 프레스 75톤 500X500Mm 플래튼 프로그래밍 가능 온도 및 압력 램프 수냉식

품목 번호: XP60



소개

실험실 및 파일럿 규모 적용 분야에 이상적인 이 75톤 자동 가열 프레스는 넓은 500x500mm 플래튼, 프로그래밍 가능 램프 기능이 있는 듀얼 독립 PID 온도 제어, 폐쇄 루프 압력 프로파일링, 급속 냉각을 위한 내장 수냉 채널을 특징으로 합니다. 지금 견적을 요청하세요.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
탄소 섬유 복합재 성형	항공우주, 자동차 및 스포츠 용품용 경량 구조 패널, 판 또는 구성 요소로 탄소 섬유 또는 유리 섬유 강화 열가소성 또는 열경화성 프리프레그의 고온 및 고압 통합.	전체 500×500 mm 영역에 걸친 균일한 압력과 온도는 공극을 제거하고 일관된 섬유 함침 및 기계적 특성을 보장합니다.
다층 PCB 및 CCL 라미네이션	다단계 온도 및 압력 프로파일을 사용하여 다층 인쇄 회로 기판, 동박 적층판 및 플렉서블 회로의 정밀 핫 프레스으로 안정적인 층간 분당 달성.	프로그래밍 가능 램프 제어는 열 충격을 최소화하고バリ, 뒤틀림 및 수지 짜내짐을 방지하여 높은 신뢰성 기판을 생성합니다.
고체 전지 전해질 및 전극 프레스	전고체 배터리를 위한 고밀도 및 긴밀한 계면 접촉을 달성하기 위해 세라믹 또는 폴리머 고체 전해질 층 및 복합 전극의 핫 프레스.	폐쇄 루프 압력 프로파일링 및 균일 가열은 향상된 이온 전도도 및 기계적 무결성을 가진 조밀하고 결합 없는 전해질 테이프를 보장합니다.
연료 전지 MEA 제조	PEM 연료 전지를 위해 제어된 열과 압력 하에서 촉매 코팅 멤브레인과 가스 확산층을 분당하여 멤브레인 전극 어셈블리(MEA) 제조.	섬세한 힘 제어 및 정밀한 온도 균일성은 멤브레인 손상을 방지하면서 최적의 촉매층 접착력과 성능을 달성합니다.
반도체 웨이퍼 본딩	MEMS, 센서, 3D 통합 및 고급 패키징을 위한 반도체 웨이퍼 또는 장치 기판의 열압축 본딩으로, 종종 열팽창의 정밀한 정렬이 필요합니다.	프로그래밍 가능 램프 및 플래튼 전체의 ±1°C 온도 안정성은 열 불일치 응력을 최소화하고 균일한 본딩 품질을 보장합니다.
폴리머 필름 및 시트 생산	광학 필름, 포장 재료 또는 연구 샘플의 샘플 준비 또는 소규모 생산을 위한 열가소성 필름, 시트 또는 적층판의 압축 성형 및 평탄화.	고압력 능력 및 급속 수냉으로 빠른 사이클 시간을 허용하고 제어된 두께의 평평하고 응력이 제거된 필름을 생산합니다.
복합재 시험 샘플 준비	ASTM/ISO 방법에 따라 복합재 적층판 또는 접합부에서 표준화된 시험편 준비, 기계적 시험을 위한 반복 가능한 시험 품질 보장.	자동화된 프로그래밍 가능 사이클은 일관된 샘플 준비를 제공하여 변동성을 줄이고 시험 데이터의 신뢰성을 향상시킵니다.
제약 정제 압축 연구 개발	열 활성화가 필요한 제제를 평가하거나 빠르게 붕괴되는 제제를 생산하기 위해 가열 다이를 사용하여 제약 분말을 정제로 소량 핫 압축.	빠른 냉각 기능이 있는 프로그래밍 가능 압력 및 온도 프로파일을 통해 정제 정도, 기공률 및 용해 특성을 정밀하게 제어할 수 있습니다.

매개변수	사양
모델	XP60
최대 압력	75톤 (750 kN) - 자동 유압 시스템
압력 제어	램프 기능이 있는 프로그래밍 가능 (폐쇄 루프 자동)
플래튼 작업 온도	0 - 300 °C
가열 제어	듀얼 플래튼 독립 가열, 램프 기능이 있는 PID 프로그래밍 가능 제어; 다단계 온도 프로파일 지원
플래튼 크기	500 × 500 mm

매개변수	사양
플래튼 개방	100 mm
가열 전력	약 10 kW (고출력 듀얼 존 가열)
냉각 방식	순환 수냉 (외부 쿨러 필요)
전원 공급	AC 380V/50Hz 또는 AC 208V/240V/480V 3상 60Hz (요청 시 미국 시장에 맞춤 구성 가능)
장비 치수	약 680 × 680 × 1280 mm (산업용 수직 고강성 프레임)
순중량	약 1130 kg (중장비 장비, 전문 지게차 하역 필요)